

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-0731

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称	博时基金 大成基金 东方红基金 光大保德信 国金基金 国联安 华安基金 华富基金 华润元大 华泰柏瑞 华泰自营 汇丰晋信 汇添富 交银基金 金元顺安 摩根基金 南方基金 宁银理财 鹏华基金 平安资管 浦银安盛 人保资产 太平基金 泰康基金 泰信基金 天弘基金 西部利得 兴全基金 兴业基金 兴银理财 易方达 银河基金 银华基金 永赢基金 长信基金 招银理财 国信证券 申万宏源 金鹰基金 长江证券 嘉实基金 华福证券 招商基金 富国基金 华泰证券 中欧基金
时间	2025 年 7 月 30 日、31 日

上市公司接待 人员姓名	董事长 戴保家 董事、副总经理 赵锡凯 董事、董事会秘书、副总经理 韩旻 证券事务代表 白伟扬
投资者关系活 动主要内容介 绍	Q: 近期, 在上海市服务业发展引导资金 2025 年第一批拟支持项目名单公示中, 有出现公司《基于 3DDRAM 堆叠封装的云端大算力芯片设计平台建设》项目, 具体情况如何? A: 该项目结合国内供应链的特点, 围绕合规路径进行技术储备和平台建设, 目标为云端算力需求客户提供合规的高性价比解决方案。 Q: 公司 ASIC 业务的主要布局方向? A: 主要方向大致概括如下: 1) 智能穿戴/眼镜类; 2) 端侧 SOC 类; 3) RISC-V 类; 这些领域的需求正不断上升, 且对芯片的高智能、低功耗的性能表现也提出了更高要求。公司充分发挥在基带 SoC 芯片领域深耕多年的相关优势, 借助长期积累的 IP 库、成熟的供应链渠道、以及从底层架构到上层应用的全链条技术能力, 持续满足相关客户的定制化需求。 4) 云端推理芯片项目 公司将有针对性地利用在大型 SoC 芯片及系统级设计方面长期积累的技术优势, 通过技术创新与新型架构设计, 与客户合作开发特定的合规方案, 助力其实现规模量产。 Q: 公司对 ASIC 业务发展怎么看? 在当前组织架构下,

	该业务是否设有独立团队？公司如何在人力资源有限的情况下，平衡芯片产品与 ASIC 项目的投入，确保两者均能有序发展？ A:我们注意到，自去年下半年以来，随着各项技术尤其 AI 大模型不断发展、新应用加速落地，传统通用芯片渐难以有效服务特定场景，因此芯片定制需求持续增长，市场空间不断扩容。尽管当前 ASIC 团队同时服务自研芯片、外部定制服务及 IP 授权业务，人力资源存在上限，但公司可以通过一些措施来进行平衡，比如通过业务优先级排序调控进度，复用既有 IP 模块与项目经验以减少重复开发，优化人力投入等。现阶段通过这些措施的实施，可以保障各业务有序推进。未来，随着芯片定制业务的发展，不排除设立独立团队的可能。 Q：公司在 ASIC 业务上的竞争优势主要体现在哪些方面？ A：从过去跟客户合作历史来看，所有项目实现 100%成功交付。主要优势如下： 1、平台化优势与可复用经验：作为一家 SoC 芯片平台公司，公司积累了大量自有芯片产品的设计和流片经验。这种平台化的能力和经验可以高效复用于 ASIC 定制服务中，不仅能为客户显著缩短研发周期、提升开发效率，更能确保项目的成功率。 2、强大的复杂项目设计与验证能力：公司拥有丰富的 SoC 项目经验，擅长处理高复杂度的芯片设计与验证工作。 3、成熟的供应链渠道：公司与头部晶圆厂及封装测试厂商建立了稳定、长期的合作关系，可以根据客户需求灵活对
--	--

	接各类工艺；凭借丰富的流片、封装到测试的完整供应链管理经验和提供成熟可靠且具备性价比优势的“一站式”（Turnkey）代量产服务。 4、丰富的 IP 资源与自研成本优势：公司拥有多样化的 IP 类型，能够满足不同客户需求。公司自研手机芯片，因此在 DDR、PCIE、USB 等高速接口 IP 上拥有深厚积累和自研能力，相比外购 IP，自研 IP 的可靠性和适配性更高，成本控制能力更强。 Q：公司在 ASIC 业务上的收入预期如何？ A：公司目前订单承接情况良好，由于大型 ASIC 项目固有的长周期属性，结合各项目的推进计划，预计 2026 年 ASIC 业务收入将取得大幅增长。 需特别说明的是，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、项目交付进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。 Q:请问公司 RedCap 芯片的最新市场进展情况？ A：在 5G RedCap 领域，公司首款芯片 ASR1903 已率先在物联网市场实现商用，已获得中国移动、中国联通两大运营商的认证，且客户进展较为顺利，目前 1903 已经有 10+客户如移远，Simcom，美格，有方，中移物联，移科等共 30+模组及产品送样测试或者发布，场景包括车载，MBB，工控等领域。 面向智能穿戴市场，公司推出的 RedCap 芯片平台 ASR3901 已具备量产商用能力，该平台将为 5G RedCap 智能穿戴终端提供高效、经济且性能卓越的解决方案，助力 5G 智能穿戴市场的繁荣与多样化发展。目前已经有 15+款终端完
--	---

	成入网入库测试，且已经开始小规模出货。 此外，公司开发的全球首款 RedCap+Android 智能芯片平台 8603，不仅支持 5G RedCap 与 LTE Cat.4 双模，同时采用高性能 1xA76+3xA55 架构，凭借高效 GPU、自研 ISP 和 NPU，展现出色的 AI 与多媒体性能，今年第一季度推出后受到市场广泛关注，目前处于客户 Design in 阶段，预计终端产品将于今年第四季度上市。 Q：公司对于 2025 年下半年蜂窝物联网领域的景气度展望如何？ A：从运营角度初步来看，目前客户终端提货及需求计划情况良好，下游客户有向上修正需求的迹象，整体相对乐观。 Q：公司 4G/5G 智能手机芯片的研发及进展情况如何？ A：首款 4G 4 核芯片：已经成功实现商用。2024 年出货量超过百万颗，充分验证了其性能表现以及平台系统的稳定性与可靠性。目前在手订单充足，预计 2025 年全年出货量较 2024 年实现成倍增长。 首款 4G 8 核芯片：今年上半年公司已经完成多项目、多客户导入。该款芯片在导入手机项目的同时，支持客户拓展智能模组、车载座舱、平板电脑等产品线。首发智能手机客户预计 2025 年第三季度实现产品上市。 第二代 6nm 4G 8 核芯片：今年上半年已流片。该款芯片具有较高的技术规格，比如支持 LPDDR5/5X，提供 6400Mbps 以上的数据吞吐率，搭载 20TOPS 算力的独立 NPU，可以支持目前各种主流的适用于移动终端的大模型。预计 2025 年 9 月底左右回片，年底开始导入客户，2026 年上半年逐步进入客
--	---

	户量产阶段。 首款 6nm 5G 8 核芯片：已进入研发后期。该款芯片具备先进的 5G-A 通信能力及高性能 AI 能力，将进一步完善公司智能手机芯片的产品布局。预计 2025 年下半年流片，2026 年下半年开始客户导入工作。 Q: 公司未来毛利率的变化趋势和影响因素是什么？ A: 公司毛利率的变化主要受市场竞争格局、业务与产品结构的影响，未来趋势也基本围绕这些因素展开，公司现有三类主营业务（芯片销售、定制业务、IP 授权）的毛利水平本身存在差异，且同一业务类别内不同项目、不同产品的毛利也存在差异。因此，即使单一产品未降价，营收中各类业务、产品的收入占比变化，也会直接影响整体毛利率。未来公司将通过优化业务及产品结构、强化产品竞争力应对市场变化，不过受竞争格局与产品结构动态调整等因素影响，毛利率仍可能存在波动，具体将取决于各因素的实际作用情况。 Q: 公司是否有发行可转债或在香港上市的融资计划？ A: 公司目前暂无发行可转债或发行 H 股（在香港上市）的计划，未来将结合融资环境及公司自身情况综合考量。后续若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。 Q: 公司对今年的研发费用以及期间费用如何展望？ A: 公司将坚持降本增效，聚焦核心研发项目投入，通过优化资源配置、提升研发及运营效率，争取将期间费用及研发费用的增长控制在较去年不超过 15% 的水平。具体数据请
--	--

	以年度审计报告披露为准，敬请投资者注意相关投资风险。
附件清单 (如有)	无